

セミコン・ジャパン2009のご案内

2009年11月吉日

お客様各位

日本電子材料株式会社
取締役 営業統括部長 大澤茂巳

拝啓

貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、本年も例年通りセミコン・ジャパン2009に出展する運びとなりました。多様化するウェハー・テストに向け、プロービングの技術革新をお客様と実現したいと考えております。弊社が掲げる *Your Probing Partner* を合言葉に、お客様に信頼され、期待に応えるべく大いなる創造力を確かな技術に結びつけていきます。

ご多忙のこととは存じますが、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 期間 2009年12月2日(水) ~ 4日(金)
2. 場所 幕張メッセ
3. ブース 6A - 206
4. 出展品 **【Memory】**
 - NEW** MC Series
FLASH Memory, 300mm/1TD
 - 【System on Chip】**
 - NEW** VT Series
Peripheral Fully Contact, 2Die, ADVANTEST T6577
 - VS Series
Flip Chip, 2Die, ADVANTEST T2000
 - CN Series
Peripheral Fully Contact, 4Die, ADVANTEST T6577
 - 【Image Sensor】**
 - VE Series
CCD, CMOS Image Sensor, 32Die, TERADYNE IP750